



2023年12月期2四半期 決算説明資料

株式会社RS Technologies

2023年8月10日



プライム市場
3 4 4 5

目次

1.会社概要 P.3

会社概要
沿革
製造拠点の紹介
現在のRS Technologies
ウェーハ再生事業の地域別出荷数構成比

2.2023年12月期第2四半期 決算概要 P.14

第2四半期決算概要（累計）
第2四半期セグメント及び会社別動向（累計）
決算概況(4-6月)
セグメント及び会社別動向（4-6月）
セグメント動向 四半期業績グラフ
会社別動向 四半期業績グラフ
貸借対照表

3.中期経営計画（23年～25年） P.22

中期経営計画の概要
2023年12月期 決算見通し
設備投資計画：ウェーハ再生事業、プライムウェーハ事業
中国投資計画（スケジュール）
中国12インチプライムウェーハ(マーケット戦略)
ウェーハ再生事業の需要先
地域戦略
再生ウェーハの需要見通し
第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略
RS Technologiesの目指す世界

4 .Appendix P.36

代表取締役 方永義の強み
ウェーハ再生ビジネス(1) (2)
プライムウェーハビジネスへの進出
中国における当社合弁相手について
山東省徳州市との提携について
中国事業への出資スキーム
12インチプライムウェーハ事業スキーム
中国子会社(GRITEK)の上場と資本政策
中国子会社(GRITEK)上場時の状況
業績推移・主要財務諸表・セグメント別業績推移等

1. 会社概要

会社概要

- ウェーハ再生で世界市場シェア1/3の**トップ企業**※1。
- 中国中央政府直属企業との合併事業で**プライムウェーハ事業**にも本格進出。
- M&Aによりシナジーの期待できる**周辺事業領域**にも事業を拡大。

社名	株式会社RS Technologies
設立	2010年12月10日
経営理念	「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
事業内容	電子材料、電子機器部品、通信機器部品材料の製造、加工、再生、販売。太陽光発電事業。半導体関連設備の買取及び販売事業。半導体材料・パーツの販売。半導体シリコンウェーハ製造の技術コンサルティング。
本社所在地	東京都品川区大井1-47-1 NTビル 12F
三本木工場	宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2
資本金	5,579百万円（2022年12月末時点）
代表取締役	方 永義
主な連結子会社	艾爾斯半導体股份有限公司（台湾）資本金 NT \$300 million 出資比率 100%
	北京有研RS半導体科技有限公司（北京）登録資本 US \$138 million 出資比率 45% ※2
	有研半導体硅材料股份公司（北京）登録資本 10億人民元 出資比率 40.09% ※2
	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション 資本金 27百万円 出資比率 100%
	山東有研半導体材料有限公司（山東省徳州市）登録資本 15億人民元 出資比率 32.02% ※2
	株式会社DG Technologies 資本金 100百万円 出資比率 100%

※1 SEMIデータに基づき弊社にて推計。

※2 2022年12月末現在

沿革

- ウェーハ再生事業で世界トップ。中国の大手プライムウェーハメーカーを連結子会社化、ウェーハ総合メーカーに。
- 2020年10月、山東省徳州市において、山東GRITEKの新工場が竣工、生産開始。

2010年（平成22年）12月	ウェーハ再生事業を主たる事業として株式会社RS Technologiesを設立
2014年（平成26年）2月	台湾に子会社として艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）を設立
2015年（平成27年）3月	東京証券取引所マザーズに株式を上場
2015年（平成27年）6月	最先端設備を導入した三本木工場・第8工場が竣工
2015年（平成27年）12月	艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）の台南工場が竣工
2016年（平成28年）9月	東京証券取引所市場第一部（東証一部）へ市場変更
2018年（平成30年）1月	北京有研RS半導体科技有限公司（BGRS）を設立、中国プライムウェーハ製造メーカーである有研半導体材料有限公司（GRITEK）を連結子会社化
2018年（平成30年）5月	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの100%株式を取得(日立パワーデバイスの特約店)
2018年（平成30年）8月	山東有研半導体材料有限公司(GRITEKの連結子会社、山東GRITEK) を設立
2019年（平成31年）1月	株式会社DG Technologies（DG）の100%株式を取得
2019年（令和元年）12月	有研科技集团有限公司（GRINM）、徳州滙達半導体股權投資基金パートナー企業及び山東省徳州市政府と四者間で合弁契約を締結（SGRS）
2020年（令和2年）2月	上海悠年半导体有限公司（上海ユニオン）を設立
2020年（令和2年）3月	山東有研RS半導体材料有限公司（SGRS）並びに有研艾唯特（北京）科技有限公司（北京IVT）を設立
2020年（令和2年）10月	中国におけるプライムウェーハの生産拠点となる、山東GRITEKの新工場が竣工、生産開始
2022年（令和4年）3月	監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
2022年（令和4年）4月	東証一部からプライム市場へ移行、及び、指名報酬委員会（任意）を設置
2022年（令和4年）6月	DGの第2の生産拠点として、栗原工場（宮城県栗原市）が竣工
2022年（令和4年）11月	GRITEK（有研半導体硅材料股份公司）が上海証券取引所科創板市場へ上場

三本木工場（RSテクノロジーズ、ウェーハ再生事業）

- 2011年1月、操業開始。
- 2015年6月、最先端設備を導入した第8工場生産開始。



社名	株式会社RS Technologies
設立	2010年12月
製品	5,6,8,12インチ再生ウェーハ
生産能力	8インチ：月産15万枚 12インチ：月産30万枚
所在地	宮城県大崎市
認証	ISO9001、ISO14001

台南工場（RSTW、ウェーハ再生事業）

■2015年12月、艾爾斯半導體股份有限公司（RSTW）台南工場生産開始。



社名	艾爾斯半導體股份有限公司
竣工	2015年12月
製品	12インチ再生ウェーハ
生産能力	12インチ：月産20万枚
所在地	台湾台南市
認証	ISO9001、ISO14001

徳州工場（山東GRITEK、8インチプライムウェーハ事業）

- 2018年8月、山東有研半導体材料有限公司(GRITEKの連結子会社、山東GRITEK)を設立。
- 2020年10月、新工場が竣工を迎え、プライムウェーハの新たな製造拠点として稼働開始。



社名	山東有研半導体材料有限公司
竣工	2020年10月
製品	5,6,8インチプライムウェーハ
生産能力	5インチ：月産5万枚 6インチ：月産15万枚 8インチ：月産13万枚
所在地	中国山東省徳州市
認証	ISO9001、ISO14001

SGRS研究開発センター（SGRS、12インチプライムウェーハ事業、北京市）

- 2020年3月、山東有研RS半導体材料有限公司（SGRS）を設立。
- 2021年に月産1万枚の開発ラインを設置、品質向上及び量産化のための研究開発を実施中。



社名	山東有研RS半導体材料有限公司
設立	2020年3月
製品	①12インチプライムウェーハ ②12インチ再生ウェーハ
生産能力	①月産1万枚(開発ライン) ②月産5万枚(2022年度より)
所在地	中国山東省徳州市※

※写真は、中国北京市にあるSGRS研究開発センター

神栖工場（DGテクノロジーズ、半導体関連装置・部材等事業）

- 2019年1月、株式会社DG Technologies を連結子会社化。
- 拡大する需要に対応すべく、設備投資及び生産性改善による増産を実施中。



社名	株式会社DG Technologies
設立	1981年10月
製品	ドライエッチング装置向け 石英・シリコン製消耗部材
所在地	茨城県神栖市
認証	ISO9001

栗原工場（DGテクノロジーズ、半導体関連装置・部材等事業）

- 2021年5月、宮城県に栗原工場を立ち上げ。
- 従来からの生産拠点である神栖工場と栗原工場（新設）の2拠点体制で、増加する受注に対応。



シリコン電極



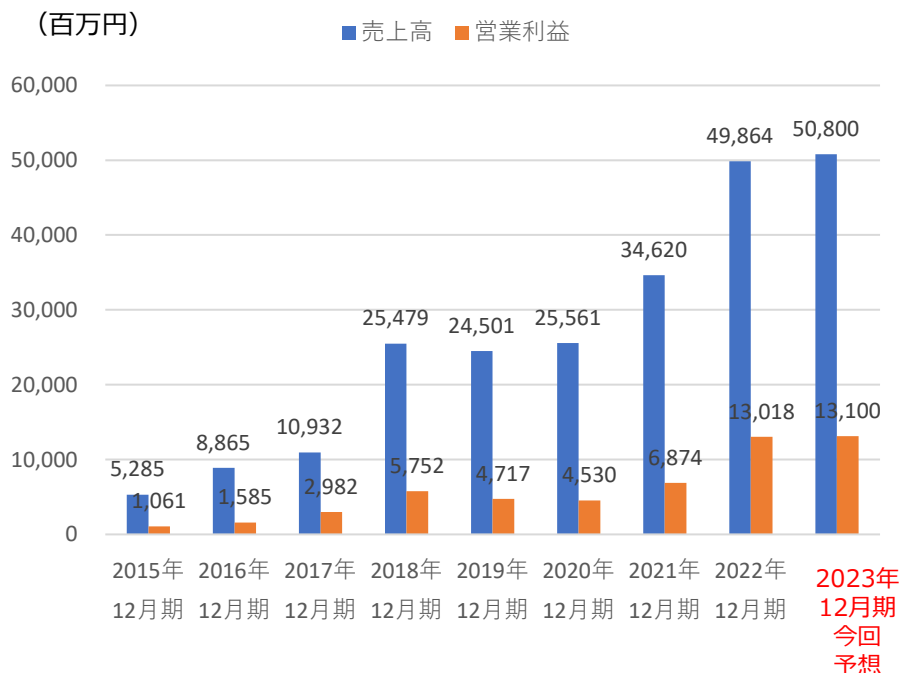
石英リング

社名	株式会社DG Technologies
稼働開始	2021年5月
製品	ドライエッチング装置向け 石英・シリコン製消耗部材
所在地	宮城県栗原市
建物面積	5,000㎡

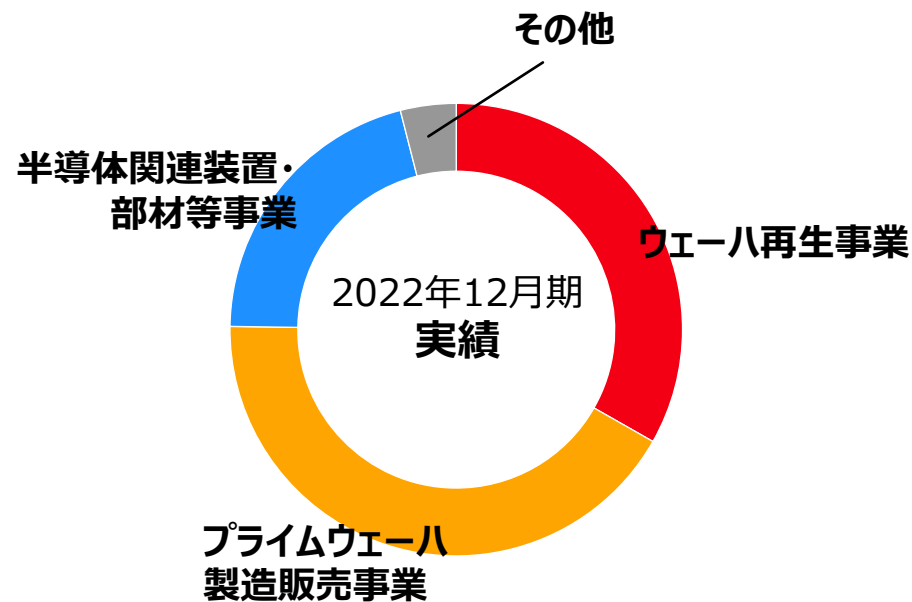
現在のRS Technologies

- ウェーハ再生事業 + プライムウェーハ事業の総合ウェーハメーカー。
- 半導体関連装置・部材等事業及びソーラー事業へも事業領域を拡大。
- ウェーハ再生事業はグローバルシェアNo1、プライムウェーハ事業では中国国内向けを中心に事業を展開。

連結売上高および営業利益

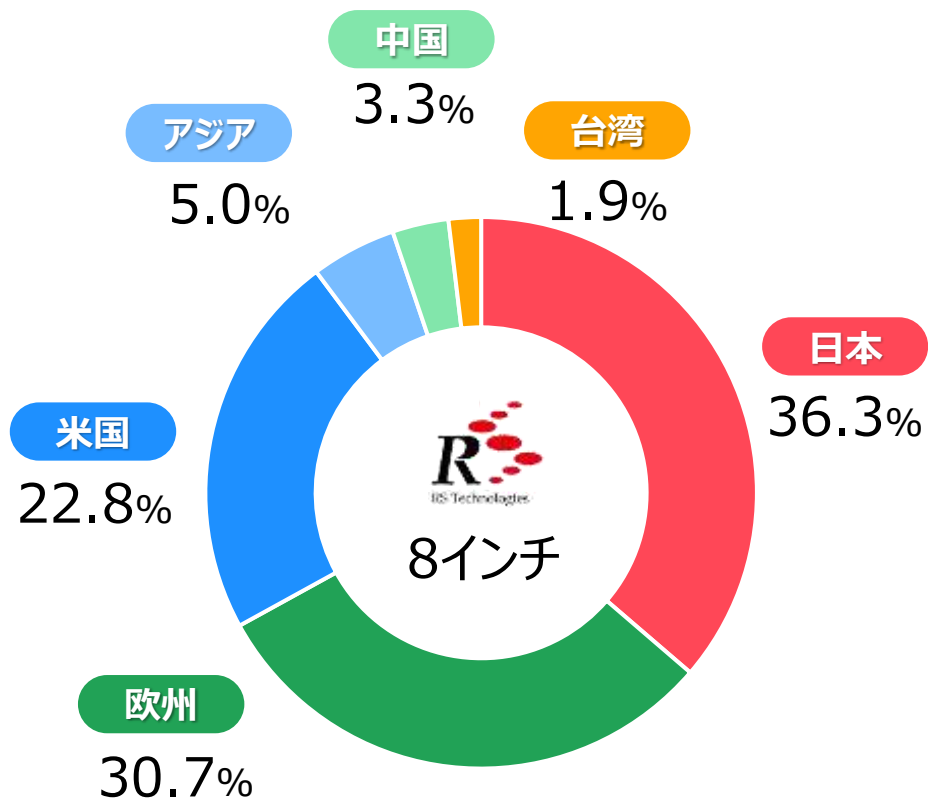
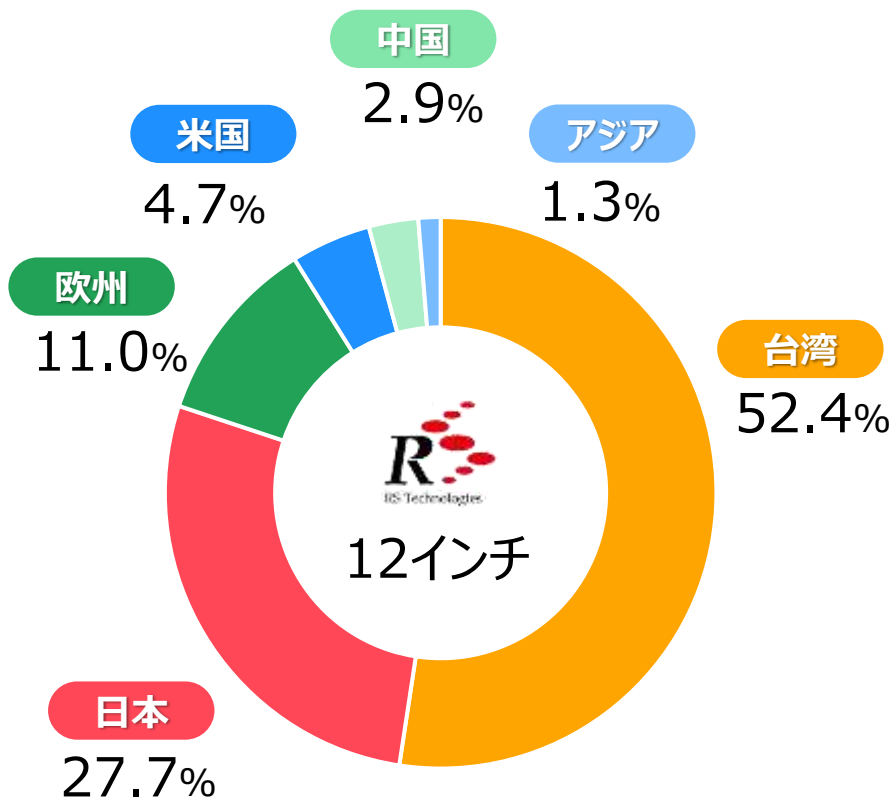


セグメント別売上高



ウェーハ再生事業の地域別出荷数構成比

- 日本、台湾、欧米を中心に、世界の主要な半導体メーカーを顧客としている。
- 日台中の3製造拠点体制で今後の需要拡大に対応。



(2023年度)

2. 2023年12月期第2四半期 決算概要

2023年12月期第2四半期 決算概況

■売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益

全て、順調に推移し、前年同期比増収増益

■通期（年間）見通しに向けても順調に推移

※一株当たり当期純利益は2023年1月1日の株式分割後の値にて表示

(百万円)	2022年12月期 第2四半期	2023年12月期 第2四半期	前期比	前期比 増減率	2023年12月期 通期予算 進捗率	2023年12月期 通期予算
売上高	24,193	26,126	1,933	8.0%	51.4%	50,800
営業利益	6,051	6,395	344	5.7%	48.8%	13,100
営業利益率	25.0%	24.5%	△0.5pt			25.8%
経常利益	7,425	7,741	316	4.3%	54.1%	14,300
経常利益率	30.7%	29.6%	△1.1pt			28.1%
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,336	3,722	386	11.6%	50.3%	7,400
一株当たり 当期純利益	129.01円	141.64円	12.63円	9.8%		143.09円

2023年12月期第2四半期（累計） セグメント及び会社別動向

- ウェーハ再生事業は、堅調な顧客需要により、前年同期比増収増益。
- プライムウェーハ事業は、市場環境の変化等により、前年同期比減収減益。
- 半導体関連装置・部材等事業は、大口案件等の獲得により、前年同期比増収増益。

セグメント別 (百万円)	ウェーハ再生事業		プライムウェーハ 製造販売事業		半導体関連装置・ 部材等事業		その他、調整額		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	9,669	20.1%	10,233	△11.6%	6,832	24.1%	△608	—	26,126	8.0%
営業利益	3,606	15.8%	2,609	△15.2%	609	58.2%	△429	—	6,395	5.7%
営業利益率	37.3	△1.4pt	27.2	0.6pt	8.9	1.9pt	—	—	24.5	△0.5pt

会社別 (百万円)	RS		台湾子会社		中国子会社		その他、調整額		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	9,243	15.5%	5,576	20.3%	10,353	△11.0%	957	—	26,129	8.0%
営業利益	1,992	9.9%	1,551	23.7%	2,611	△15.0%	241	—	6,395	5.7%
営業利益率	21.6	△1.0pt	27.8	0.7pt	25.2	△1.2pt	—	—	24.5	△0.5pt

2023年12月期第2四半期（4-6月）決算概況

■売上高は増加、

営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益については減少

(百万円)	2022年12月期 第2四半期	2023年12月期 第2四半期	前年同期比	差額
売上高	13,126	13,979	6.5%	853
営業利益	3,434	3,384	△1.5%	△50
営業利益率	26.2%	24.2%		△2.0pt
経常利益	4,567	4,105	△10.1%	△462
経常利益率	34.8%	29.4%		△5.4pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,108	2,018	△4.3%	△98
一株当たり当期純利益	81.50円	76.77円	△5.8%	△4.73円

2023年12月期第2四半期（4-6月）セグメント及び会社別動向

- ウェーハ再生事業は、旺盛な顧客需要により前年同期比増収、利益は微減。
- プライムウェーハ事業は、市場環境の変化等により減収減益
- 半導体関連装置・部材等事業は、営業体制強化、大口案件売上等により増収増益

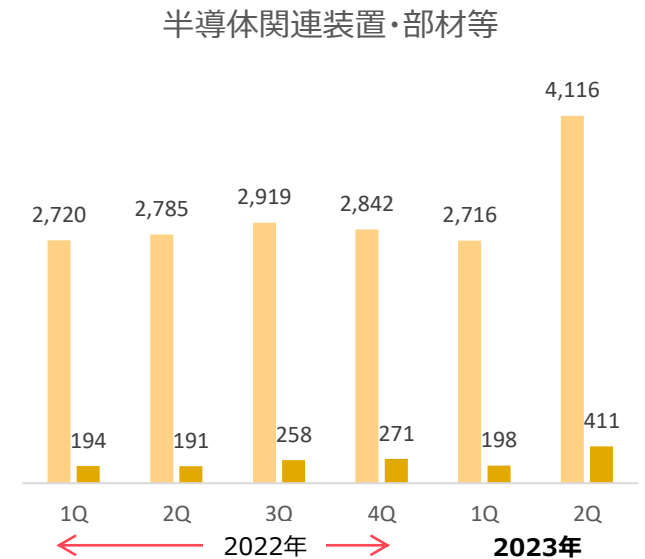
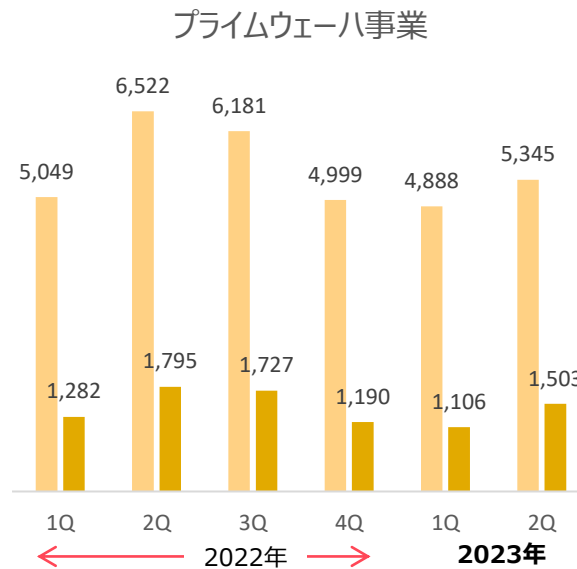
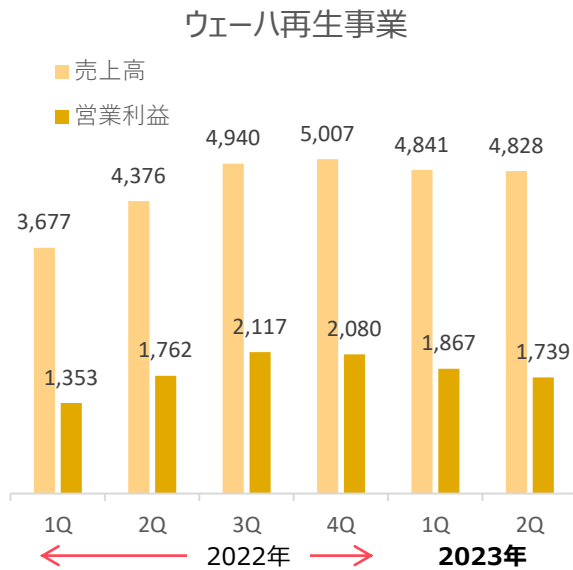
セグメント別 (百万円)	ウェーハ事業		プライムウェーハ 製造販売事業		半導体関連装置・ 部材等事業		その他、調整額		連結合計	
		前年同期比		前年同期比		前年同期比		前年同期比		前年同期比
売上高	4,828	10.3%	5,345	△18.0%	4,116	47.8%	△310	-	13,979	6.5%
営業利益	1,739	△1.3%	1,503	△16.3%	411	101.1%	△314	-	3,384	△1.5%
営業利益率	36.0	△4.3pt	32.0	4.5pt	10.0	2.8pt	-	-	24.2	△2.0pt

会社別 (百万円)	RS		台湾子会社		中国子会社		その他子会社		連結合計	
		前年同期比		前年同期比		前年同期比	連結消去	前年同期比		前年同期比
売上高	5,256	28.6%	2,866	13.6%	5,362	△18.4%	495	-	13,979	6.5%
営業利益	1,048	6.8%	776	8.2%	1,483	△17.3%	77	-	3,384	△1.5%
営業利益率	19.9	△4.1pt	27.1	△1.3pt	27.7	0.5pt	-	-	24.2	△2.0pt

2023年12月期第2四半期 セグメント動向 四半期実績グラフ

- ウェーハ再生事業は、堅調な顧客需要により、前年同期比増収増益。
- プライムウェーハ事業は、市場環境の変化等により、前年同期比減収減益。
- 半導体関連装置・部材等事業は、大口案件等の獲得により、前年同期比増収増益。

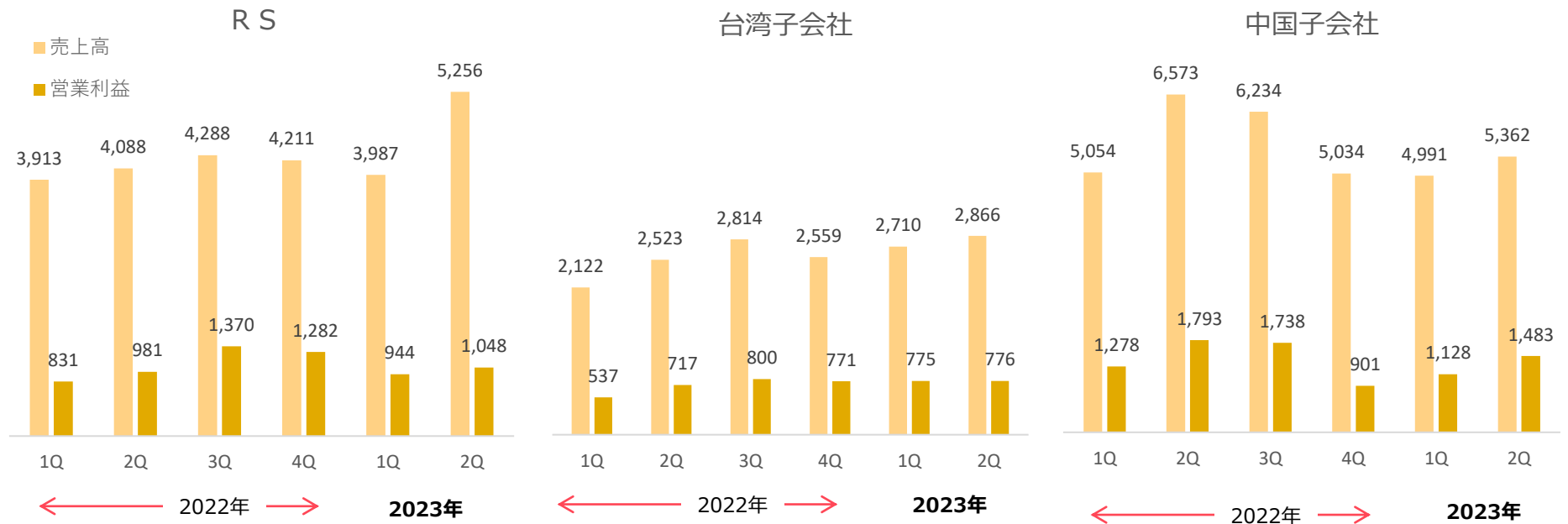
(百万円)



2023年12月期第2四半期 会社別動向 四半期実績グラフ

- RSは、ウェーハ再生事業及び半導体関連装置・部材等事業が堅調に推移。
- 台湾子会社は、顧客需要が強く、堅調な推移。
- 中国子会社は、市場環境の変化等により、前年同期比減収減益。

(百万円)



貸借対照表

■ 収支が順調に推移したこと等により、純資産は前年度末対比97億円増の1,112億円

連結貸借対照表

(百万円)	2022年12月期	2023年12月期 第2四半期
資産の部		
流動資産	90,470	93,001
現金及び預金	67,939	69,972
受取手形及び売掛金	11,651	12,683
商品及び製品	3,833	4,044
固定資産	37,084	40,754
有形固定資産	31,285	33,084
無形固定資産	270	204
投資その他資産	5,528	7,466
資産合計	127,554	133,755
負債の部		
流動負債	17,622	14,698
支払手形及び買掛金	6,466	5,741
有利子負債	4,694	3,521
固定負債	8,458	7,881
長期借入金	3,514	2,912
負債合計	26,081	22,580
純資産	101,473	111,175
負債・純資産合計	127,554	133,755

3. 中期経営計画

中期経営計画（3か年）の概要

- 2023年度売上高は半導体市場の停滞感、米中貿易摩擦影響はあるが、2022年度以上の見通し
営業利益は燃料代、材料値上げ等はあるが前年度並み以上の見通し
経常利益は2022年度為替影響等を除き、前年度並み以上の見通し
- ウェーハ再生事業は、需要を見極めたタイムリーな投資を実施し、シェアNO1を維持・拡大
- プライムウェーハ事業は、安定した生産及び市場を見極めた投資を実施し、シェアを拡大
- 半導体関連装置・部材等事業は、新市場開拓やグループシナジーの活用による成長戦略を実施

	2022年 12月期	2023年 12月期	2024年 12月期	2025年 12月期
	実績	計画	計画	計画
売上高	49,864	50,800	54,900	57,600
営業利益	13,018	13,100	14,000	14,700
営業利益率	26.1%	25.8%	25.5%	25.5%
経常利益	15,500	14,300	15,400	16,100
経常利益率	31.0%	28.1%	28.1%	28.0%
親会社株主に帰属 する当期純利益	7,739	7,400	7,600	8,000
一株当たり 当期純利益	299.29	286.18	293.91	309.38

2023年12月期 決算見通し

- 売上高は増加、営業利益は材料、燃料代の値上げ等はあるが、前年度以上の見通し
 経常利益は減少だが、2022年度為替差益等の特殊要因を除き、前年度以上の見通し

(百万円)	2022年12月期 (2022年1月～12月)	2023年12月期 (2023年1月～12月)	前期比	
	通期実績	通期予想	増減	増減率
売上高	49,864	50,800	+936	+1.9%
営業利益	13,018	13,100	+82	+0.6%
営業利益率	26.1%	25.8%	△0.3Pt	
経常利益	15,500	14,300	△1,200	△7.7%
経常利益率	31.0%	28.1%	△2.9Pt	
親会社株主に帰属する当期純利益	7,739	7,400	△339	△4.4%
一株当たり当期純利益	299.29	286.18円	△13.11	△4.4%
年間配当金	35.0円	35.0円	—	—

*本会計年度から、連結での当期決算見通し数値は、会社別の開示はいたしません。
 現時点の関係各社の情報をもとにRSテクノロジーズがまとめた業績予想です。

設備投資計画：ウェーハ再生事業

- 世界の半導体需要が拡大する中、日本・台湾での増産、及び、中国山東省において量産中
- 旺盛な需要に対応すべく、台湾の2023年～2025年の投資額増額を決定、2025年には月産28万枚へ

日本

総投資額： 25億円

- 12インチ再生ウェーハの生産能力拡充及び微細化対応
- 2023～2025年：25億円(4万枚)

12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

2022年	2023年	2024年	2025年
30万枚	31万枚	32万枚	34万枚

2023年度	2024年度	2025年度
10億円	2億円	13億円

台湾

総投資額： 36億円

- 12インチ再生ウェーハの生産能力拡充及び微細化対応
- 2023～2025年：36億円(8万枚)

12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

2022年	2023年	2024年	2025年
20万枚	23万枚	26万枚	28万枚

2023年度	2024年度	2025年度
11億円	10億円	15億円

中国

総投資額： 36億円

- 12インチ再生ウェーハ生産拠点の新設投資
- 第1期投資(2021～2023年)：36億円(5万枚)
- 第2期投資(2024年～)：投資額未定（5万枚）

12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

2022年	2023年	2024年	2025年
5万枚	5万枚	5万枚	10万枚

第1期投資

2023年度	2024年度	2025年度
1億円	未定	未定

※ 35億円は2022年度までに投資済み

設備投資計画：プライムウェーハ事業

- 8インチプライムウェーハは、月産13万枚から18万枚までの増産を予定
- 12インチプライムウェーハは、月産5万枚の量産設備を2023年に設置し、2024年の稼働を予定

中国 8インチ

- 安定した量産体制の構築、及び、生産効率の向上を目指す

8インチプライムウェーハ生産能力（月産）

2022年 → 2024年
13万枚 → **18万枚**

2023年度	2024年度	2025年度
20億円	4億円	未定

中国 12インチ

- 12インチプライムウェーハ量産化のための研究開発
- 1万枚の開発ラインを経て、30万枚の量産体制を目指す

12インチプライムウェーハ生産能力（月産）

2022年 → 2024年 → 202X年
1万枚※1 → **5万枚** → **30万枚**

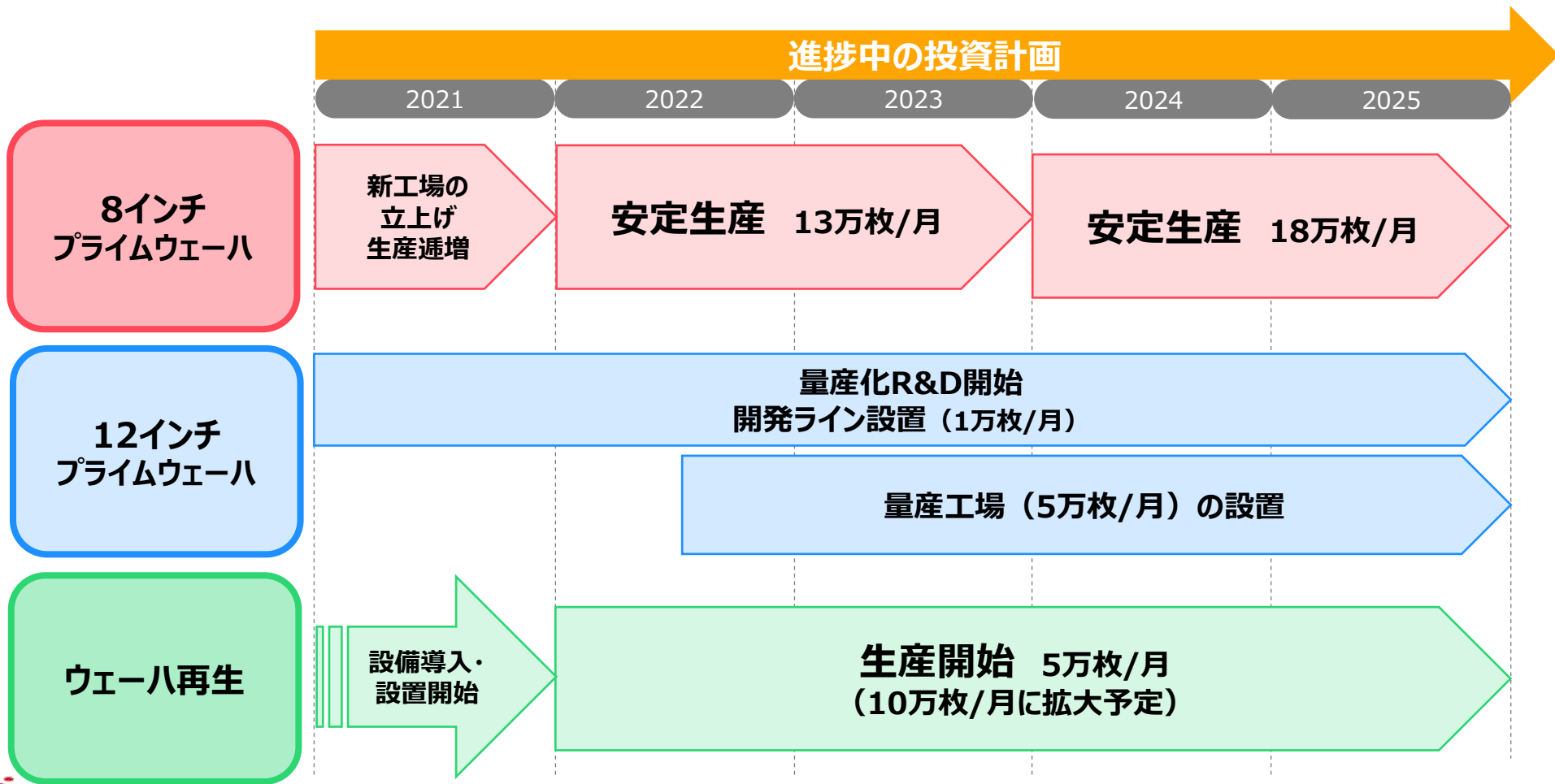
2023年度	2024年度	2025年度
240億円 ※2	20億円 ※2	未定

※1 量産化研究開発のための開発ライン

※2 12インチ事業は持分法適用会社からの投資となります。

中国投資計画（スケジュール）

- 8インチプライムウェーハは月産13万枚から18万枚への増産
- 12インチプライムウェーハは月産5万枚の量産ラインを設置、高品質化・安定生産を早期に目指す
- ウェーハ再生事業は月産5万枚の量産を継続



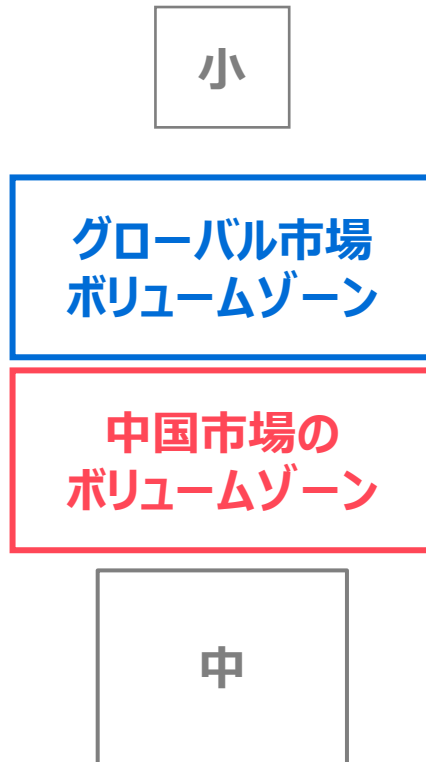
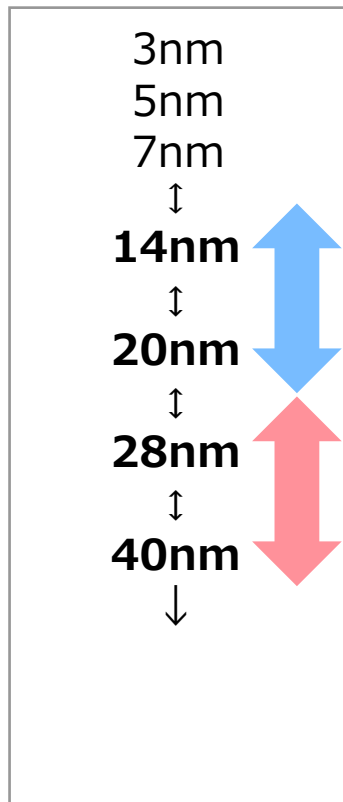
中国12インチプライムウェーハ マーケット戦略

- 中国ボリュームゾーン品質を確保し、M&A等を活用して中国シェアNo1を目指す
- 中国シェアNo1を達成しつつ、グローバル品質を実現してウェーハ再生顧客網（半導体グローバルメーカー）への販売を開始、グローバルで通用するプライムウェーハメーカーを目指す

半導体市場の技術レベルと市場規模

技術レベル

市場規模



中国プライムウェーハ事業のマーケット戦略

グローバル品質確保を目標に

品質：グローバル品質を達成
価格：中国生産による低価格の実現
販売：ウェーハ再生顧客網を活用

↓
グローバル販売を実施、シェア30%目標

12インチプライムウェーハの目標品質

品質：中国市場の**ボリュームゾーン品質を確保**

↓
価格：M&A等を活用した、低コストでの
設備取得による低価格の実現

↓
中国市場シェアNo1を実現

ウェーハ再生事業の需要先：12インチ半導体新工場

- 世界市場では、中欧米日等でメモリー・CPU・自動車の電子化等による旺盛な半導体需要に対応した、12インチ半導体新工場が建設中
- 当社は、日本、台湾及び中国への設備投資により、新たな再生ウェーハ需要へ対応



注：RST調べ

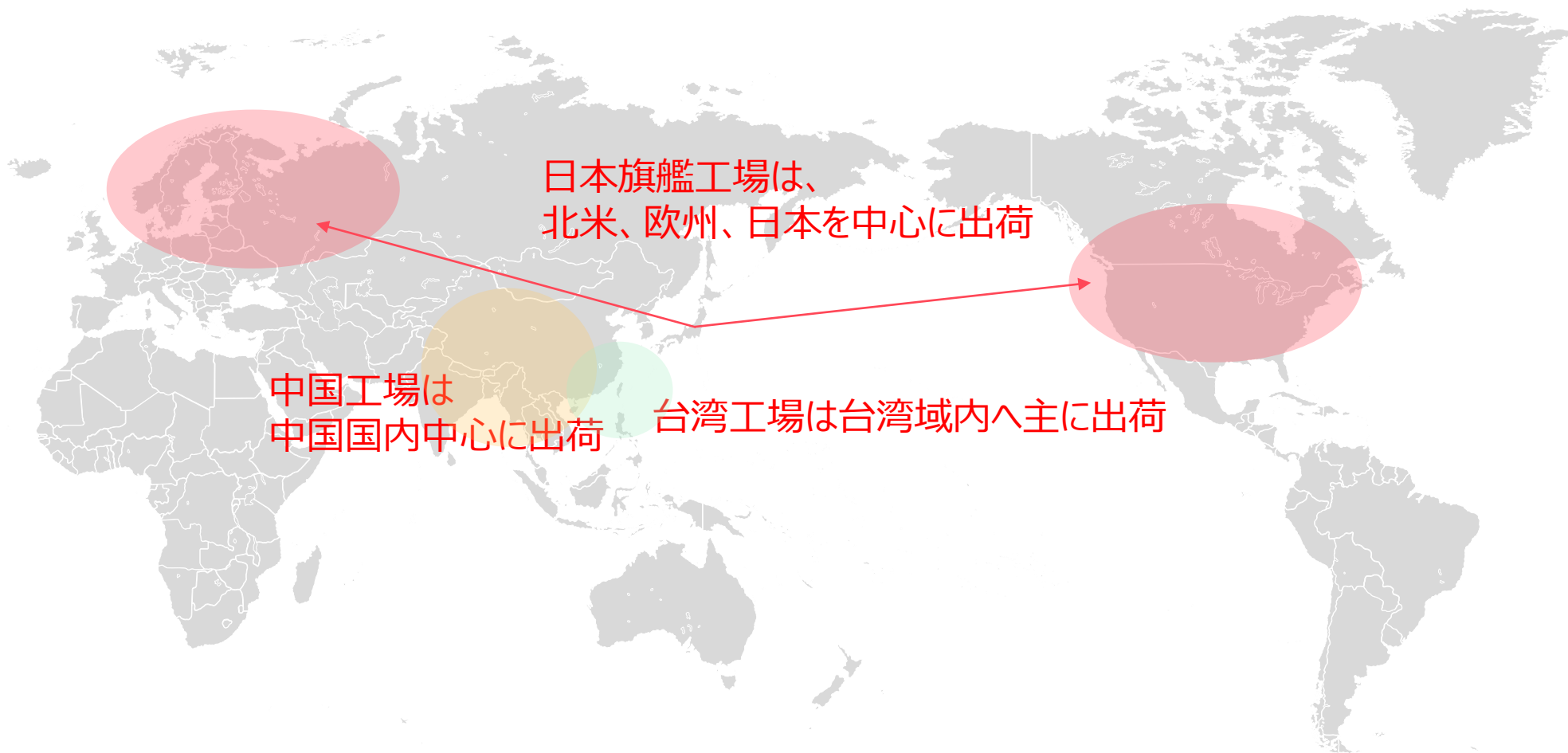
地域戦略

■ 再生ウェーハ

- ・三本木工場は北米、欧州、日本等を中心取引
- ・台湾工場は主に台湾での取引
- ・中国は中国国内中心での取引

■ プライムウェーハ

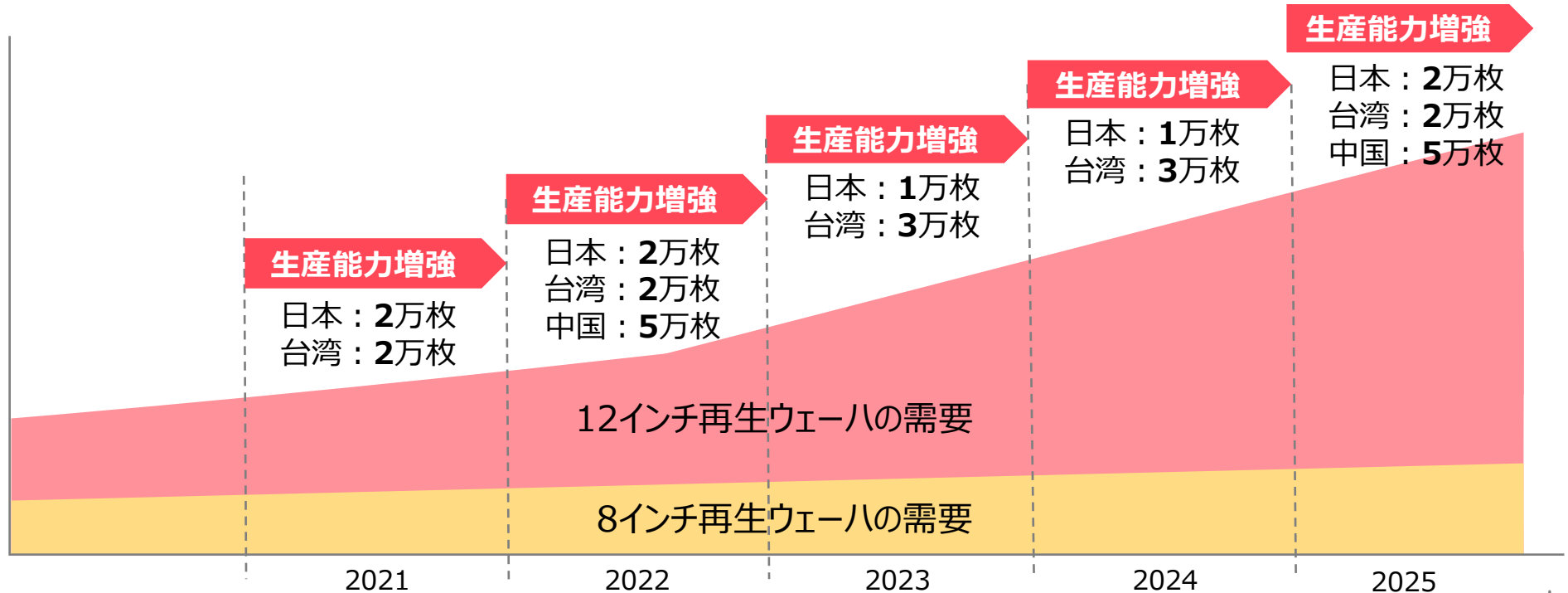
- ・販売先は中国国内が中心



再生ウェーハ需要の見通し：12インチ中心に拡大続く

- 拡大する12インチの再生ウェーハ需要に対応し、2023～2025年に日本で4万枚、台湾で8万枚、中国で5万枚の生産能力増強を予定。

生産能力	2021年末	2022年末	2023年末	2024年末	2025年末
日本	28万枚	30万枚	31万枚	32万枚	34万枚
台湾	18万枚	20万枚	23万枚	26万枚	28万枚
中国	0万枚	5万枚	5万枚	5万枚	10万枚
計	46万枚	55万枚	59万枚	63万枚	72万枚



第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略（1/3）

- DGテクノロジーズは、大手半導体製造メーカーや半導体設備メーカーへ消耗部材を製造販売する部材メーカー。
- 2019年1月に、当社連結子会社化。

会社概要

DGtec 株式会社DGテクノロジーズ

社名	株式会社DG Technologies
設立	1981年10月26日
事業内容	半導体製造装置向けの消耗部材の製造・販売
所在地	茨城県神栖市砂山3-4
資本金	100,000千円
代表取締役	方 永義

製品

ドライエッチング装置向け
石英・シリコン製消耗部材



シリコン電極



石英リング

主な顧客

半導体製造メーカー
半導体設備メーカー 等

第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略（2/3）

- ドライエッチング装置向け部材市場は推定1500億円*1で今後も成長が見込まれる。
- RS既存ウェーハ顧客への営業とGRITEK仕入によるシナジー、及び、生産能力拡大と生産効率化による成長戦略を策定・実施。同市場におけるトップシェアを狙う。

市場の成長性

ドライエッチング装置向け
石英&シリコン消耗部材市場



約1,500億円
*1

ドライエッチング装置市場と
同程度の成長を期待

(先行指標)

ドライエッチング
装置市場



成長率
8% *2

成長戦略

- ◆ 営業活動の強化
RS既存ウェーハ顧客へのクロスセルを実施
- ◆ 生産能力の増強
設備投資を実施し、顧客の要求数量をタイムリーに生産・出荷する体制を構築
- ◆ 生産効率の向上
生産能力増強と合わせて、人員・生産工程等の最適化を行い生産効率向上を図る
- ◆ 仕入の最適化
当社グループ会社のGRITEKより原材料仕入を行うことで、競争力強化を図る

第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略（3/3）

- 神栖工場がフル稼働のため、拡大する顧客需要に対応すべく、2021年5月、宮城県に栗原工場を立ち上げ。
- 従来からの生産拠点である神栖工場と栗原工場（新設）の2拠点体制で、増加する受注に対応。

神栖工場



工場名

DG Technologies 神栖工場

所在地

茨城県神栖市

建物面積

5,378㎡

栗原工場



工場名

DG Technologies 栗原工場

所在地

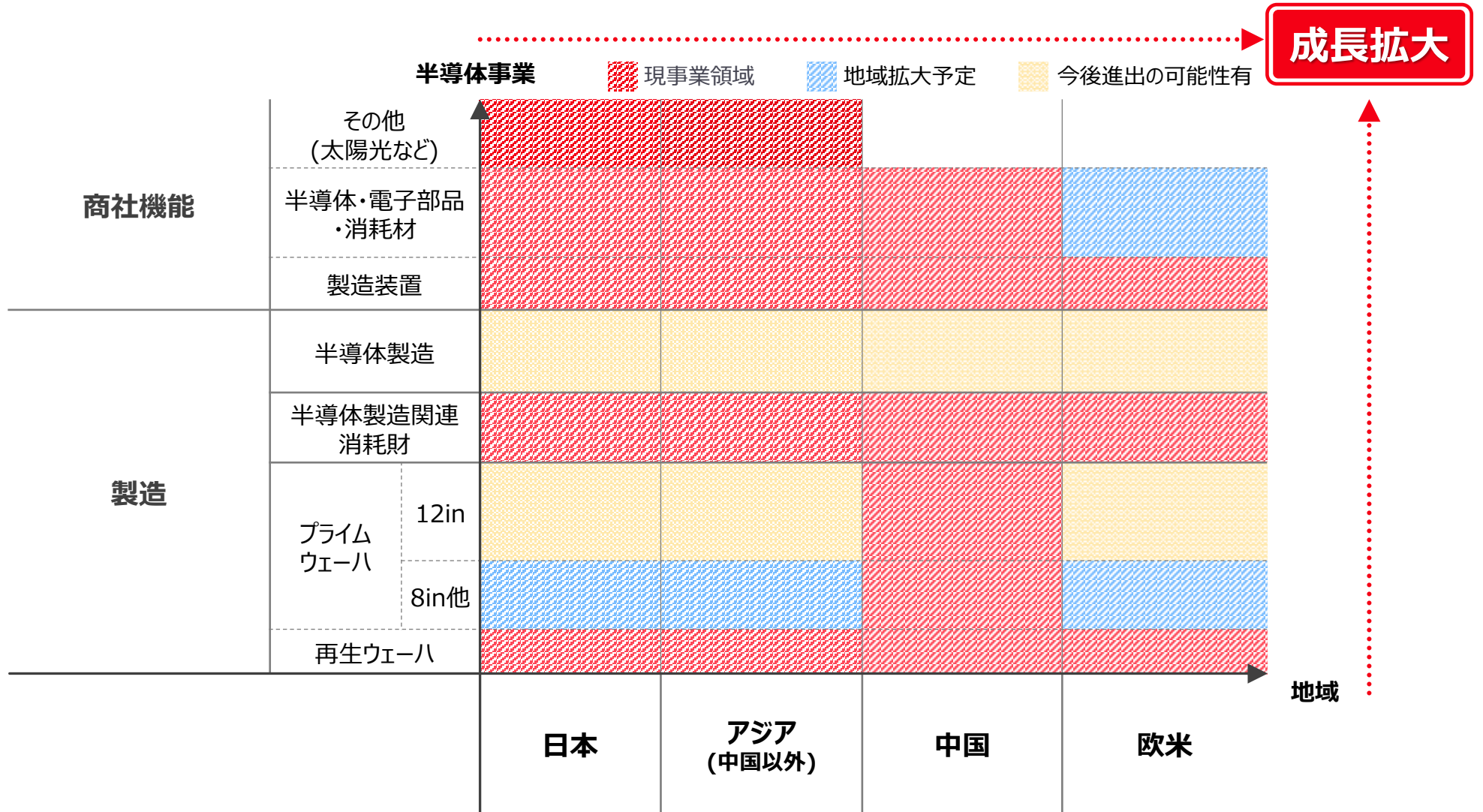
宮城県栗原市

建物面積

5,000㎡

RS Technologiesの目指す世界

- 一步一步、着実に事業領域および販売地域を広げていく。



Appendix

代表取締役 方永義の強み

- 代表取締役社長である方永義が20年以上にわたって日本で培った知見と自身が持つネットワークを生かした全世界への販売力・人脈力・提携力・資金力が強み。
- 方永義の下にハイテクや金融など幅広い分野のプロフェッショナル人財が集結。



方 永義 (ほう ながよし)

1970年生まれ 中国福建省出身
城西国際大学院 経営学博士

得意分野：
M & A、業務提携（過去10社を超えるM & Aを成功）

1998年 永輝商事設立
2010年 当社設立社長就任（現任）

大切にしている心：為せば成る

補足：

高校卒業後に来日。日本国内外で20以上の会社の投資経験。「半導体事業」の他、ファンドや貿易、ホテル、IT事業、農業等様々な業界の投資を経験。「日本のものづくりは世界一」との信条の元、それを世界に広めていくため、世界中を飛び回っている。

ウェーハ再生ビジネス(1)

顧客フォローアップ

入荷

受け入れ検査

ストリッピング/エッチング

プレソート検査

ポリッシング

1次洗浄 (1次検査)

2次洗浄

最終検査/包装

出荷

クリーンルーム

強み 1

直販体制による正確なニーズの把握

- 全ての顧客と直接コミュニケーションを行い、東京本社で管理することにより圧倒的なコストダウンを実現

強み 2

すべての膜を剥離可能

- ケミカルによる除去の為、表面のダメージが最小限に

▶ 再生回数が多い ▶ よりコストダウンが可能

ラサ工業（化学）の特異技術を継承



傷 凹み

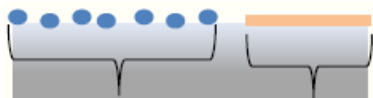
表面に付いているキズや凹凸を研磨（ポリッシング）により平滑にする



強み 3

金属不純物を除去

- ウェーハ表面の微細ゴミ・汚れを洗浄で取り除く
- + 金属不純物を除去 特に銅 (Cu) の除染除去に強み

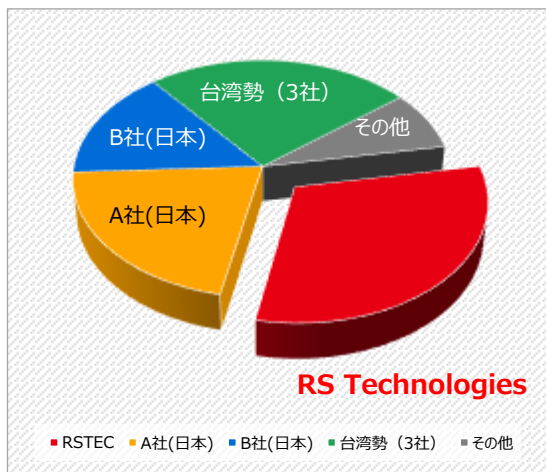


ゴミ (パーティクル) 金属不純物

ウェーハ再生ビジネス(2)

再生市場での当社のシェア拡大

12インチ再生市場における当社シェア



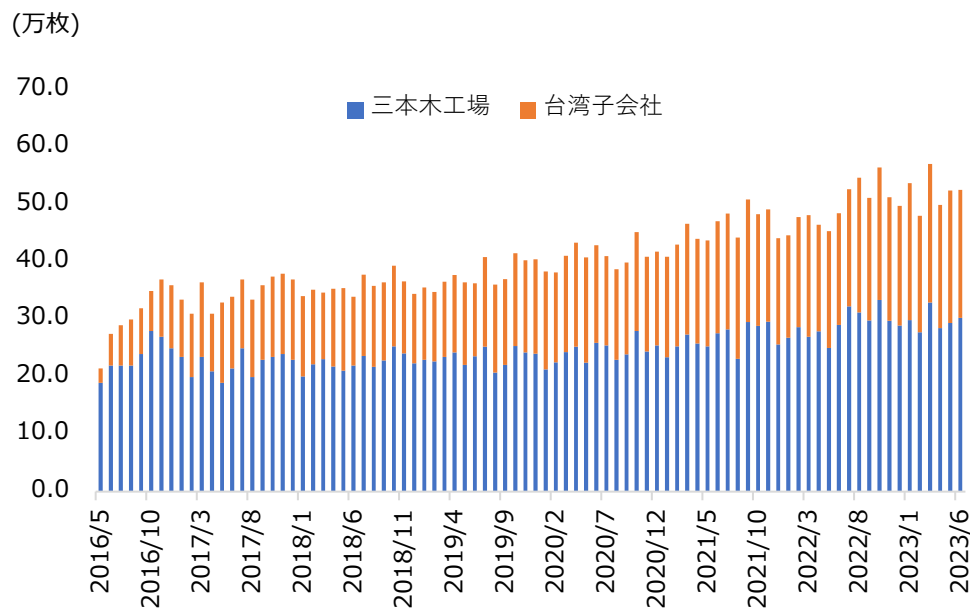
注：RST調べ

台湾の新設・三本木の増設により、生産能力が増加、現在のシェアは33%程度に上昇。

両工場の既存設備によるさらなる生産力のアップ、三本木の空工場利用、業務提携・M&A等の手法を用いて、シェアアップを目指す。

三本木工場と台湾子会社の出荷推移

三本木工場と台湾子会社の12インチウェーハ出荷枚数推移

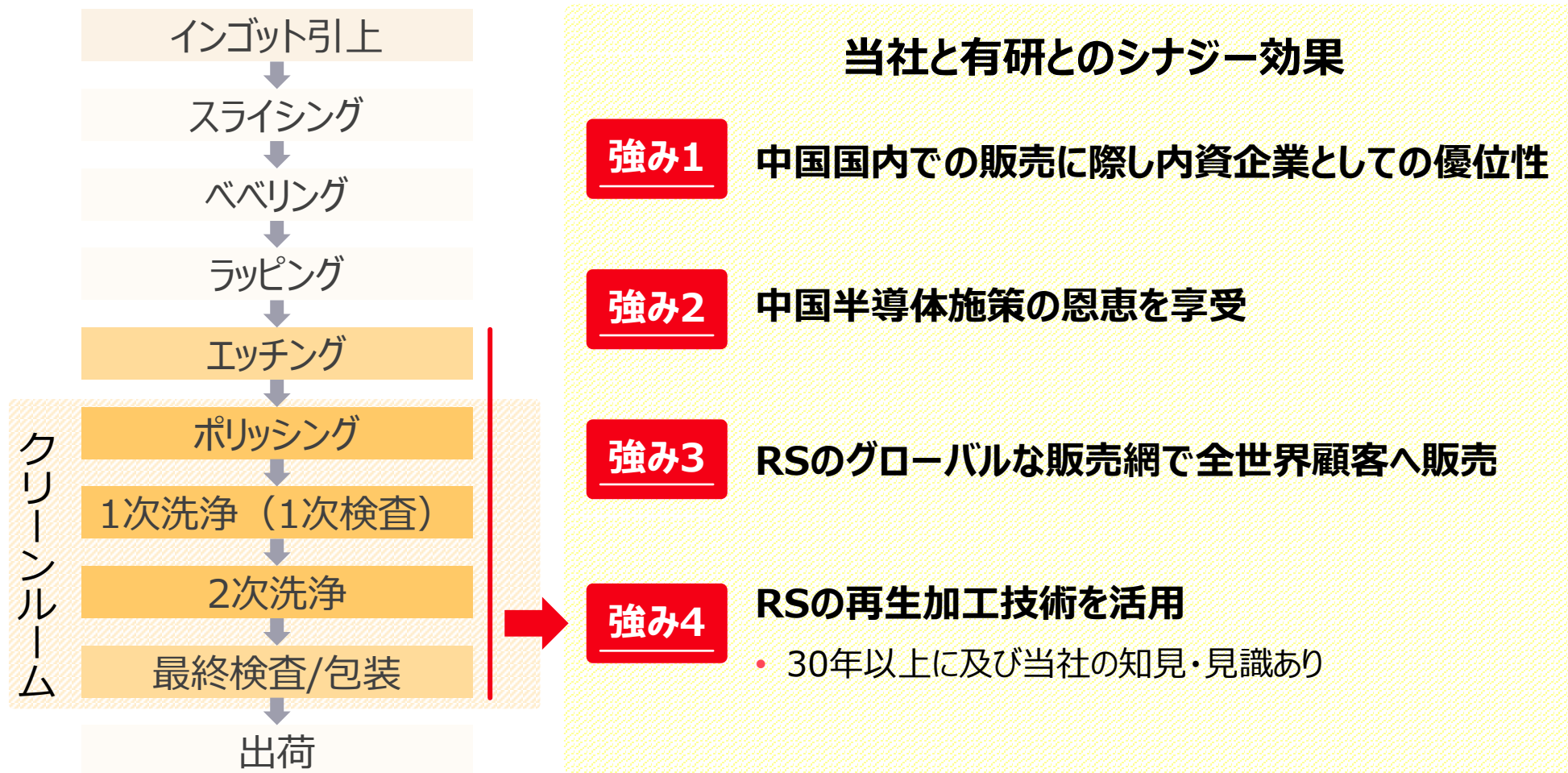


注：RST調べ

年	2015下期	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
生産能力	24万枚	28万枚	30万枚	34万枚	40万枚	42万枚	46万枚	50万枚
シェア	24%	29%	30%	31%	33%	33%	33%	33%

プライムウェーハビジネスへの進出

- 中国中央政府直属企業の北京有色金属研究総院（現 有研科技集团有限公司）との合併会社を設立。内資企業（中国の国内企業）として半導体事業を推進



中国における当社合併相手（GRINM）について

- 1952年創立。**中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関。**
- 中国の企業数約4,500万社のうち、国有企業は46万社。
その内、中央政府直属企業は97社であり、GRINMはその中の1社。
- 政府・産業・学問が一体化した研究機関で、中央政府の非鉄金属分野における方針は当該会社を通して発信される。
- 研究の成果物として事業会社を設立。現在、4つの総合研究院および事業会社約30社（上場会社2社を含む）に及ぶ。
- 当社との合併会社である北京有研RS半導体科技有限公司（BGRS）の傘下に入るGRITEKは2001年事業会社第1号として設立された。



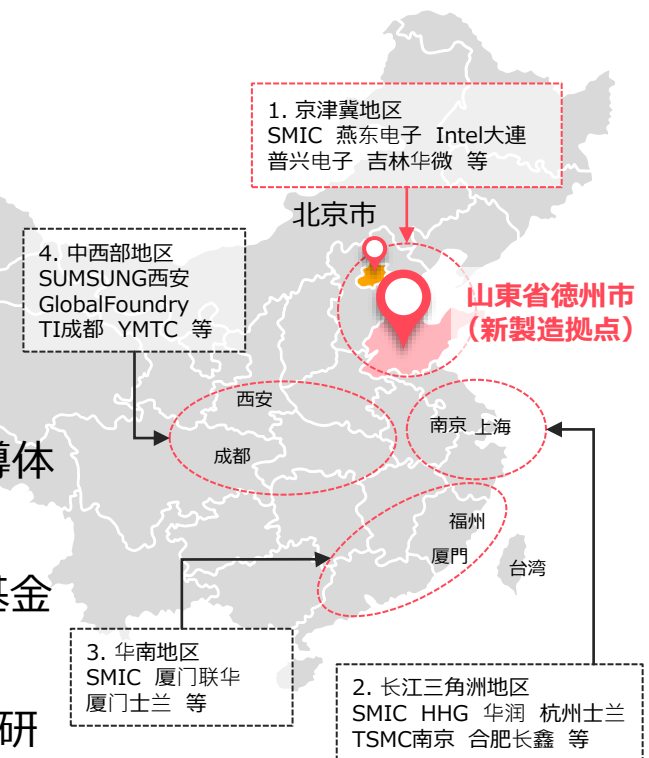
山東省徳州市との提携：背景、経緯及び現状（山東GRITEK）

提携の背景

1. 周辺に世界的な主要半導体メーカーの工場誘致が進み、半導体メーカーの集積地に近い好立地であること（右図参照）
2. 水道光熱費の低減や安価な社宅の提供といった福利厚生面が充実していること
3. 理工系大学が近隣にあり、優秀な人材獲得の面で優位性があること
4. 最大約50万㎡（当初は20万㎡）まで拡張可能な敷地により今後の中国事業推進に十分対応できる用地が確保されていること

経緯及び現状

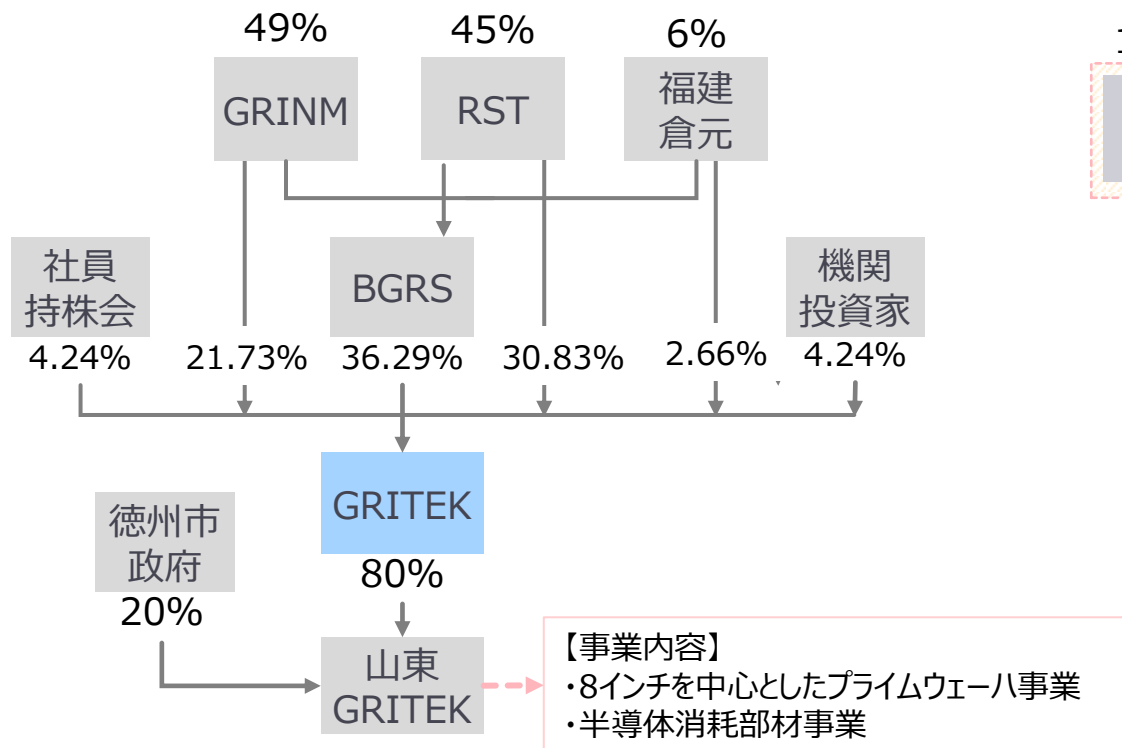
1. 2018年8月に8インチウェーハビジネスを手掛ける新会社（山東有研半導体材料有限公司）設立
2. 2019年12月に有研科技集团有限公司、徳州滙達半導体股権投資基金パートナー企業及び山東省徳州市政府と四者間で合併契約を締結
3. 2020年3月に12インチウェーハビジネスを手掛ける新合併会社（山東有研RS半導体材料有限公司）を設立
4. 2020年10月、徳州市の新工場竣工



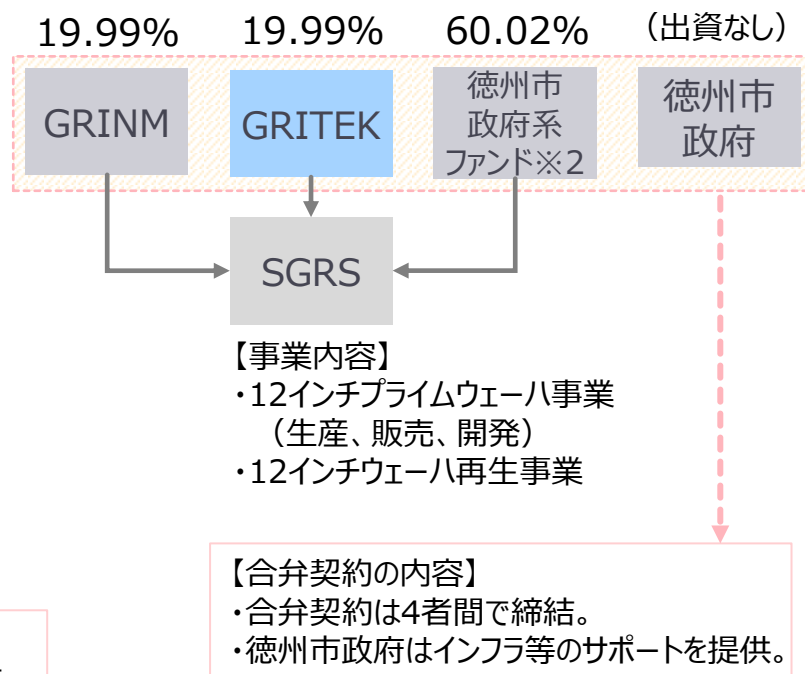
中国事業への出資スキーム

- 上場準備の一環として、BGRSが保有するGRITEK株式の一部譲渡（2020年11月開示）、GRITEKによる第三者割当増資及び当社持分法適用会社（SGRS）の株式譲渡（2021年5月開示）の実施を取締役会で決議・実施。
- 上記開示内容実施後の出資形態は以下のとおり。

8インチウェーハ事業 出資形態 ※1



12インチウェーハ事業 出資形態 ※1



※1 2021年5月19日付け開示資料「（開示事項の経過）当社海外子会社の上場準備に伴う、同子会社による第三者割当増資、及び当社持分法適用会社の株式譲渡に関するお知らせ」の開示内容を実行した後の出資形態を示しております。

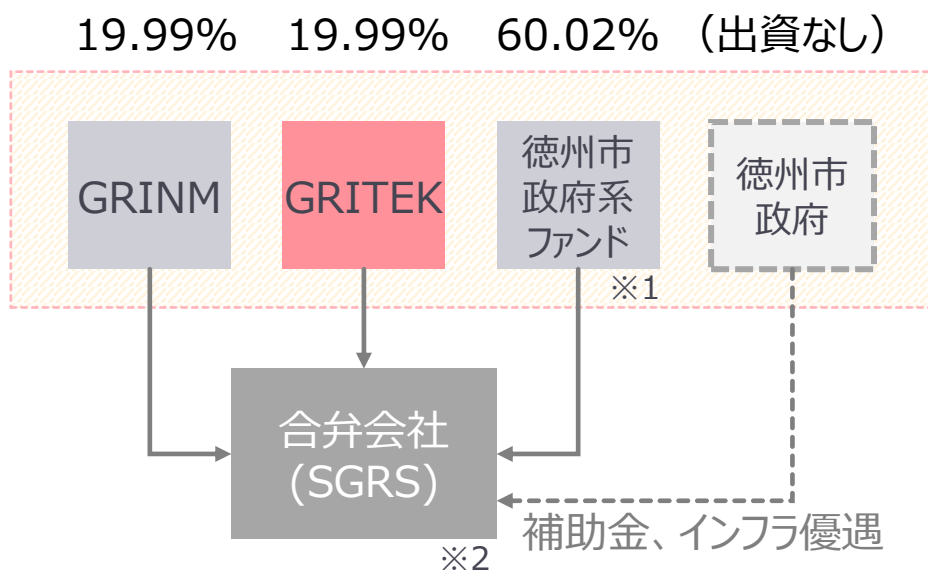
なお、SGRSへの出資比率は最終的な出資比率であり、同社への出資は、出資契約に基づき段階的に実施されます。

※2 德州滙達半導体股権投資基金パートナー企業

中国における12インチプライムウェーハ事業スキーム

- 2021年5月、当社の保有するSGRS株式をGRITEKへ譲渡(株式交換)することを取締役会で決議
- 本譲渡により、SGRSは当社連結子会社GRITEKの持分法適用会社へ(GRITEKを通じた間接的な保有へ移行)
- GRITEKを通じて12インチプライムウェーハ事業を手掛けることが、プライムウェーハ事業における戦略実現に資すると判断

SGRS株式譲渡後の出資スキーム



本譲渡におけるスキーム変更ポイント

- ◇ SGRSはGRITEKの持分法適用会社へ
→中国シリコンビジネスの一体的な運営の実現
→プライムウェーハ事業における戦略実現に資すると判断
- ◇ SGRSの董事長は当社社長の方が兼任継続
→当社子会社GRITEKを通じたコントロール継続
- ◇ 当社の権利義務はGRITEKへ包括継承
→従前より保有していた権利はGRITEKを通じて行使可能

※1 德州滙達半導体股權投資基金パートナー企業

※2 山東有研RS半導体材料有限公司

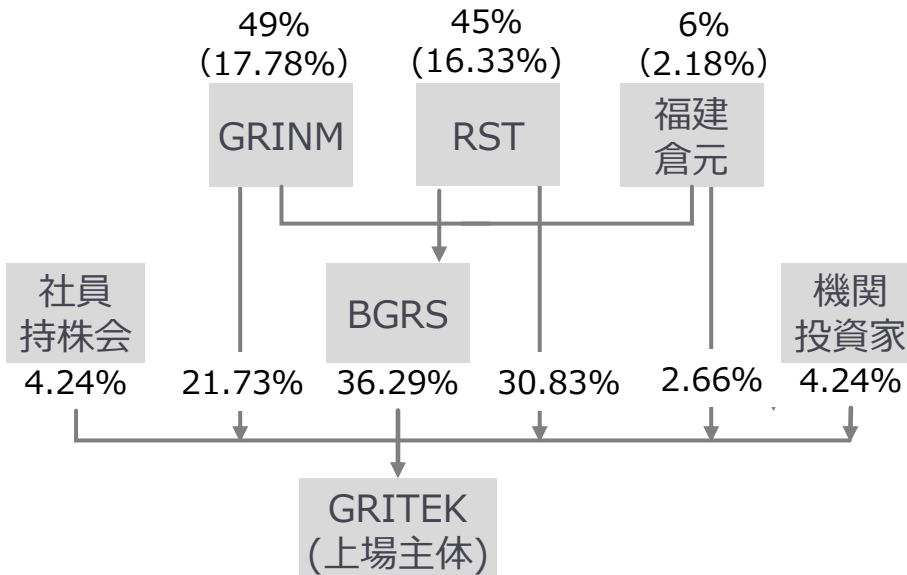
中国子会社(GRITEK)の上場と資本政策

- 中国子会社（GRITEK）が2022年11月に上海証券市場の科創板に上場
- 公募増資を実施し、資本構成が以下のように変化

上場前の資本構成

2021年5月19日付け開示資料「（開示事項の経過）当社海外子会社の上場準備に伴う、同子会社による第三者割当増資、及び当社持分法適用会社の株式譲渡に関するお知らせ」の開示内容を実行した後の出資形態。

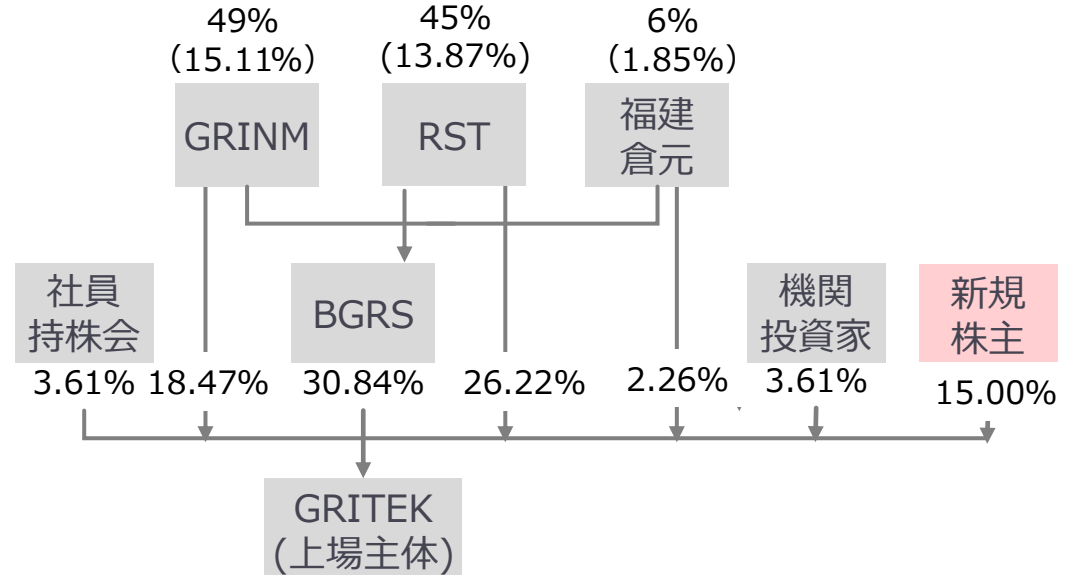
上段：BGRS所有持分
下段：(GRITEK間接所有持分)



上場時の資本構成

<新規発行株式数>
187,143,158株(発行済み株式総数の15%)
<調達金額>
約375億円

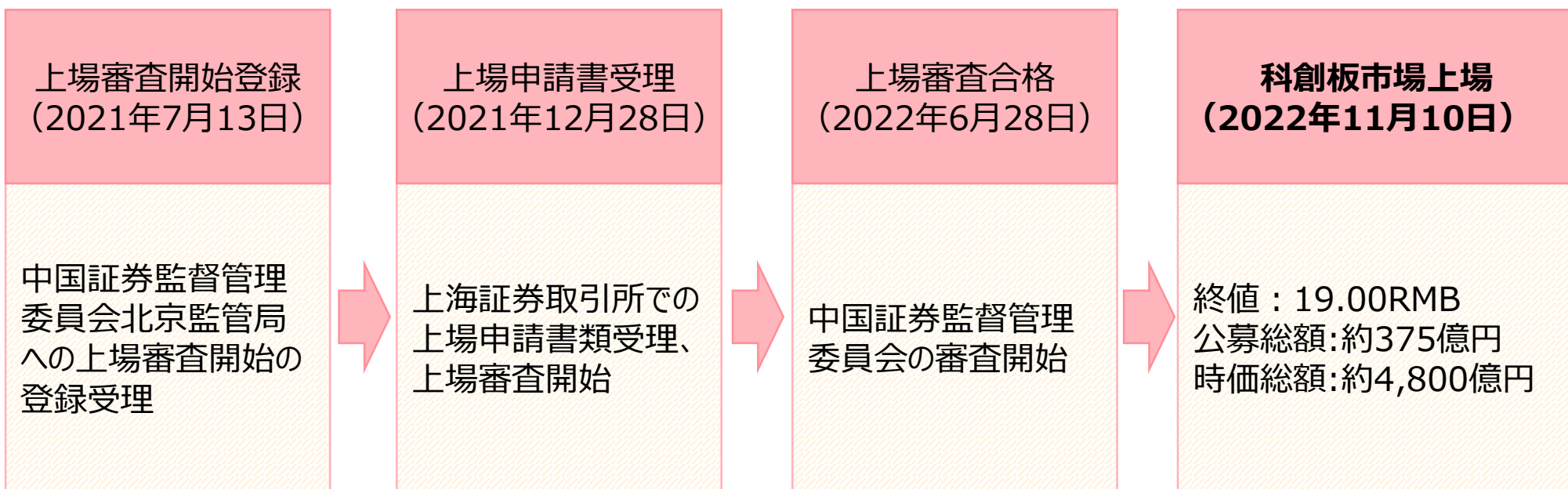
上段：BGRS所有持分
下段：(GRITEK間接所有持分)



中国子会社(GRITEK)上場時の状況

- 2022年6月28日、上海証券取引所科創板市場より、中国子会社（GRITEK）が上場審査に合格。
- 2022年11月10日、上海証券取引所科創板市場へ上場
- 公募価格、9.91RMBに対し、11月10日の終値は19.00RMBとなった
終値ベースでの時価総額は約4,800億円となった

上場スケジュール



※換算レートは11月9日TTMLレート（20.14円）

業績推移

(百万円)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
売上高	3,475	4,566	5,285	8,864	10,932	25,478	24,501	25,561	34,620	49,864
売上総利益	1,173	1,820	1,852	2,544	4,252	8,366	7,940	8,681	11,870	18,432
販管費	471	654	791	958	1,269	2,615	3,223	4,151	4,995	5,413
営業利益	703	1,166	1,061	1,585	2,982	5,751	4,717	4,530	6,874	13,018
経常利益	819	1,247	770	1,444	3,159	6,141	5,416	5,252	8,832	15,500
当期利益※	525	664	143	861	2,113	3,620	3,035	2,824	3,303	7,739
配当金 (円)	-	-	-	10	5	10	15	20	25	35
設備投資	338	3,503	4,665	209	95	1,328	4,809	12,409	7,827	5,379
減価償却費	87	103	326	682	714	1,298	1,814	1,674	2,942	3,498
研究開発費	1	6	11	85	183	501	449	929	1,308	1,657
従業員数 (正社員) (人)	152	191	265	373	434	1,159	1,277	1,187	1,333	1,533

※親会社株主に帰属する当期純利益

主要財務諸表

(百万円)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
資産の部										
流動資産	1,811	2,759	3,732	5,348	7,388	26,074	32,760	32,626	45,804	90,470
現金及び預金	397	1,190	1,842	1,952	3,243	14,879	22,156	19,082	25,438	67,939
受取手形及び 売掛金	681	696	795	2,531	2,916	6,958	6,047	6,321	9,517	11,651
商品及び製品	396	376	361	348	446	1,343	1,713	2,116	2,783	3,833
固定資産	508	4,064	5,845	5,333	4,843	10,516	15,873	26,124	33,206	37,084
有形固定資産	461	3,918	5,667	5,152	4,674	8,963	14,635	24,146	29,023	31,285
無形固定資産	19	15	29	23	19	1,099	732	527	417	270
投資その他資産	27	130	148	158	149	453	506	1,451	3,766	5,529
資産合計	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750	79,010	127,554
負債の部										
流動負債	960	2,292	2,295	2,993	3,370	4,979	7,252	12,631	14,171	17,622
支払手形及び 買掛金	138	151	186	283	398	1,554	1,614	2,871	4,317	6,466
有利子負債	136	827	1,216	1,538	1,276	976	1,730	1,522	3,020	4,694
固定負債	709	2,934	4,798	4,317	3,335	2,474	5,400	5,754	9,827	8,458
長期借入金	615	2,925	4,079	3,620	2,767	1,848	2,232	1,613	5,097	3,514
負債合計	1,670	5,227	7,093	7,310	6,705	7,453	12,652	18,385	23,999	26,081
純資産の部										
純資産	649	1,596	2,483	3,371	5,526	29,137	35,981	40,365	55,011	101,473
負債・純資産合計	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750	79,010	127,554

*2013年12月期は単独決算となっております

セグメント別 業績推移

(百万円)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
売上高										
ウエーハ再生事業	3,347	4,414	5,107	7,144	9,487	10,973	10,776	11,461	12,717	18,001
プライムウエーハ製造販売事業	-	-	-	-	-	11,918	10,058	8,755	14,780	22,752
半導体生産設備の買収・販売	-	-	-	1,654	1,393	2,918	4,047	6,272	8,450	11,265
その他、調整額	127	151	178	66	52	△331	△380	△927	△1,327	△2,154
セグメント利益										
ウエーハ再生事業	916	1,444	1,377	1,765	3,396	4,011	4,081	4,027	4,731	7,312
プライムウエーハ製造販売事業	-	-	-	-	-	2,048	1,503	1,041	2,539	5,995
半導体生産設備の買収・販売	-	-	-	230	130	366	171	211	382	914
その他、調整額	△214	△278	△316	△409	△543	△675	△1,038	△749	△778	△1,203
セグメント資産										
ウエーハ再生事業	1,337	5,040	6,987	5,657	8,120	9,150	10,336	11,698	14,302	18,530
プライムウエーハ製造販売事業	-	-	-	-	-	21,313	29,311	35,697	53,202	95,788
半導体生産設備の買収・販売	-	-	-	1,137	1,305	1,939	3,179	5,387	7,310	6,801
その他、調整額	982	1,783	2,589	3,887	2,805	4,315	5,806	5,968	4,243	6,435

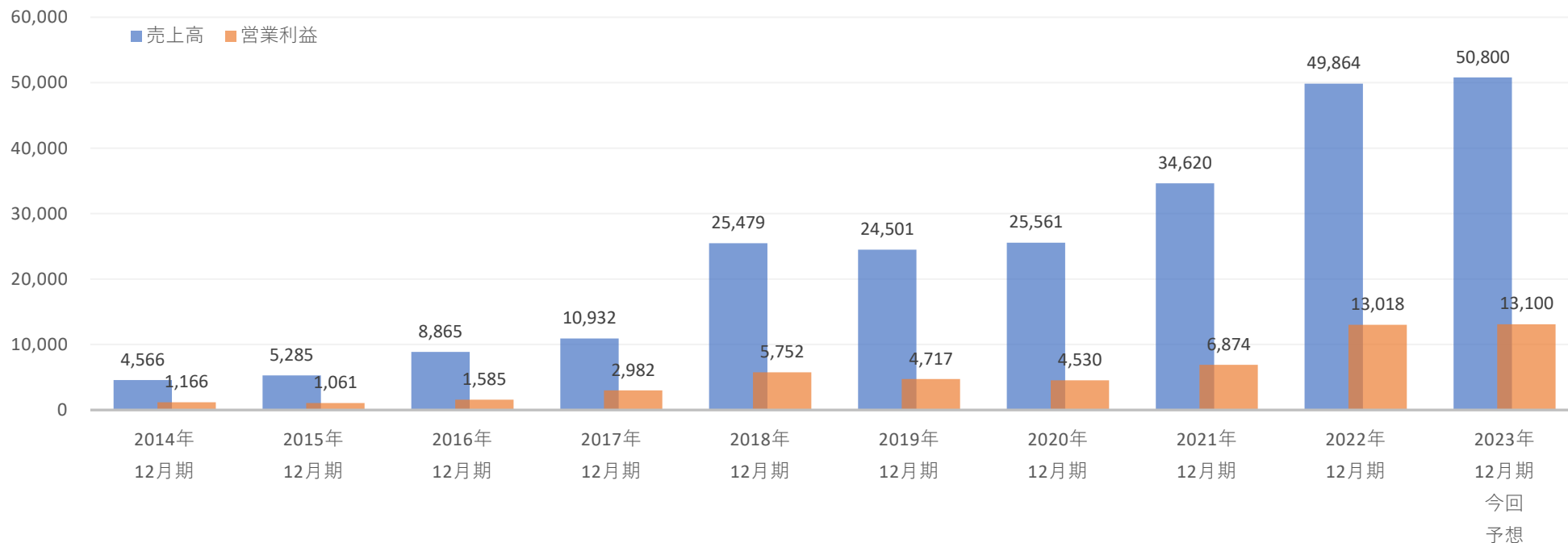
*2015年、2016年、2017年の決算数値は2019年3月5日にリリースした訂正後の数値となっております。

連結業績の推移

- 2014年2月、台湾に艾爾斯半導體股份有限公司（RSTW）を設立。翌2015年12月に台南工場竣工。
- 2015年6月、最先端設備（18インチウェーハ再生可能）を導入した三本木工場・第8工場が竣工。
- 2018年1月、中国プライムウェーハ製造メーカーである有研半導体材料有限公司（GRITEK）を連結子会社化。
- 2020年10月、中国山東省の德州工場が竣工を迎え、プライムウェーハの製造拠点として稼働開始。
- 2022年11月、GRITEKが上海証券取引所科創板市場に上場

連結売上高および営業利益

(百万円)



当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性があります。

本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。